

平成 28 年 9 月 13 日

各 位

会 社 名 ルネサス エレクトロニクス株式会社

代表者名 代表取締役社長兼CEO 呉 文精

(コード:6723、東証第1部)

問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 小林 洋一

(TEL. 03-6773-3001)

第三者割当による新株式発行等に関する資金使途および支出予定時期の変更について

ルネサス エレクトロニクス株式会社(代表取締役社長兼CEO:呉 文精、以下、当社)は、平成24年12月10日付「第三者割当により発行される株式の募集並びに主要株主、主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」において開示いたしました「調達する資金の具体的な使途」(以下、資金使途および支出予定時期)について、下記の通り変更することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 変更理由

このたび、当社は今後の戦略的集中分野において不可欠な要素デバイスのひとつであるパワーマネジメント関連アナログ製品のラインナップ強化や当社のワールドワイドトップシェアのマイコンと高精度アナログ製品をキットとしてお客様に提供するソリューション提案力の強化が、変化の激しい半導体の事業環境において優先的に必要であると考え、本日(平成 28 年 9 月 13 日)「米国 Intersil Corporation 社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」にて公表したとおり、産業やインフラ、車載、航空宇宙向けなど特に信頼性や性能が重視される市場向けに、パワーマネジメントICや高精度アナログなどのアナログ半導体製品の開発、製造、販売・サービスの提供を行う米国の半導体会社である Intersil Corporation(President, CEO and Director : Necip Sayiner、以下、インターシル社)を当社の完全子会社にすること(以下、本件買収)で同社と合意いたしました。

当社は、平成 24 年 12 月 10 日付「第三者割当により発行される株式の募集並びに主要株主、主要株主である筆頭株主、親会社及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」および平成 25 年 9 月 30 日付「第三者割当により発行される株式の募集に係る払込完了に関するお知らせ」にて開示いたしましたとおり、第三者割当増資を実施し、その調達資金を、マイコンの先端プロセス開発及び開発基盤の標準化に係る投資、生産(試作・量産)に係る設備投資、自動車向け半導体におけるソリューション投資、産業向け半導体におけるソリューション投資、並びに経営基盤再構築のための開発投資に充当するとしていました。

当社が目指す方向性に変更はないものの、当社にとって本件買収による戦略的集中分野における確固たるポジションの維持・獲得は、喫緊の対応が優先的に必要であると考え、このたび、当社が第三者割当に

より発行される株式により調達した資金の内、現時点までに具体的な資金使途が計画されている金額を除く資金を、本件買収に関するインターシル社との合意に基づき、当社がインターシル社の全株式取得に充当する資金の一部に変更することといたしました。また、電気自動車市場の立ち上がり遅れなど、計画当初に想定していた当社の注力する市場の拡大時期の変化を鑑み①から⑤の資金使途の支出時期につきましても変更することといたしました。ただし、今回インターシル社の全株式取得に充当する資金の一部に変更された①から⑤の資金使途につきましては、第三者割当により調達した資金とは別に手元資金等を充当して進める予定です。

2. 変更内容

資金使途の変更内容は以下のとおりであります。(変更箇所は下線。)

なお、第三者割当により調達した資金は、1500億円(実行日の平成25年9月30日時点)のうち現時点で約850億円について資金使途に沿った具体的な支出を計画しています。

<変更前>

調達する資金の具体的な使途

	具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①	マイコンの先端プロセス開発及び開発基盤の標準化に係る投資	<u>40,000</u>	<u>平成25年6月～平成29年3月</u>
②	生産(試作・量産)に係る設備投資	<u>20,000</u>	<u>平成25年6月～平成29年3月</u>
③	自動車向け半導体におけるソリューション投資	40,000	<u>平成25年6月～平成30年3月</u>
④	産業向け半導体におけるソリューション投資	<u>40,000</u>	<u>平成25年6月～平成29年3月</u>
⑤	経営基盤再構築のための開発投資	10,000	<u>平成25年6月～平成28年3月</u>

<変更後>

調達する資金の具体的な使途

	具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①	マイコンの先端プロセス開発及び開発基盤の標準化に係る投資	<u>4,000</u>	<u>平成25年6月～平成31年12月</u>
②	生産(試作・量産)に係る設備投資	<u>1,000</u>	<u>平成25年6月～平成28年9月</u>
③	自動車向け半導体におけるソリューション投資	40,000	<u>平成25年6月～平成37年12月</u>
④	産業向け半導体におけるソリューション投資	<u>30,000</u>	<u>平成25年6月～平成37年12月</u>
⑤	経営基盤再構築のための開発投資	10,000	<u>平成25年6月～平成29年12月</u>

⑥	インターシル社の全株式の取得費用の一部	65,000	平成 28 年 10 月～平成 29 年 6 月
---	---------------------	--------	--------------------------

「インターシル社の全株式の取得費用の一部」と致しましては、成長が見込まれる自動車向け半導体市場及び重点地域における当社の事業領域の拡大のために、製品群、提案力、販売・マーケティング力の強化に充当します。具体的には、パワーマネジメントICや高精度アナログなどのアナログ半導体製品の開発、製造、販売・サービスの提供を行うインターシル社の全株式の取得し結合を図ることで、当社は(1)今後の戦略的集中分野において不可欠な要素デバイスのひとつであるパワーマネジメント関連アナログ製品のラインナップ強化、(2)当社のワールドワイドトップシェアのマイコンとインターシル社の高精度なアナログ製品をキットとしてお客様に提供するソリューション提案力の強化、(3)日本国外における拡販力の強化、(4)複数の米半導体企業における経営経験が豊富なインターシル社のマネジメントチームが当社グループに加わることによるグローバルマネジメント力の強化を図ります。インターシル社が当社グループの一員となることは、我々が注力し、売上及び利益の拡大を目指す戦略分野において、グローバルトップであり続けるための強力な施策になると考えています。

3. 今後の見通し

本変更に伴う当社の連結業績に与える影響については本日「米国 Intersil Corporation 社の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」にて公表した買収の進捗状況に応じ、速やかに開示します。

以上